**IPhone5 remplacement u2 1608a1**

1 retirer la carte mère complètement à partir du téléphone

2 assurer la MB en utilisant un vice ou un autre outil et identifier le ic être remplacé et protéger les parties environnantes de l'excès de chaleur en couvrant avec du ruban kapton ou le blindage métallique

3 utiliser ensemble de l'air chaud à 120 degrés faible débit d'air et en utilisant une aiguille ou une pince à épiler chauffer la colle noire sur les bords de l'IC et de supprimer complètement la colle

4 les flux de mettre sur le dessus et sur les bords de l'IC pour faciliter la dispersion de la chaleur puis en utilisant une buse de 6 mm et de l'air chaud à 380deg (débit d'air réglé au minimum) appliquer de la chaleur à l'IC de façon circulaire pour environ 10/12 minutes essais avec un pick métallique constamment jusqu'à ce que la puce se déplace librement, puis retirer la puce de la carte.

5 éliminer toute trace de soudure et nettoyer les plaquettes sur l'aide de flux Mo et l'un quelconque des nombreuses méthodes actuellement démontré sur le web Personnellement, je utiliser tresse imprégnée de flux supplémentaire extrêmement attention à ne pas se détacher l'un des patins sur le pcb

6 appliquer flux sur les plots sur le CI de remplacement puis positionnez le ic sous un pochoir de la chaleur directe et appliquer la pâte de soudure au plomb sur les plots qui doit être visible. Utilisation de la chaleur 200deg et débit d'air minimum, chauffer la soudure jusqu'à ce qu'il coule autour de 30 secondes (pâte ou balles au plomb doivent être utilisés pour assurer la température minimale de fixation)

Radoub

1 appliquer flux sur les plots sur la carte mère et une très petite quantité sur le dessus de l'IC

2 placer l'IC en position sur les plots de la carte mère du CI doivent être correctement orientés à ce point

3 en utilisant une buse 6mm mis à 240deg et minimale lieu de flux d'air du pistolet à air chaud directement au-dessus du CI à une distance de l'ordre de 10 mm, les composants externes doivent être protégés de toute chaleur en tout temps le temps refusion est de 3 minutes

 (Voir les notes ci-dessous)

5 éliminer la chaleur et laisser le MB refroidir env. 5 minutes sans bouger

Notes IMPORTANTES

Soyez avisé il ya beaucoup de variables impliquées dans la soudure d'air chaud

MB = mère IC = circuit intégré

Tous les temps et les durées sont basées sur un système de refusion de bga d'air chaud entièrement fonctionnel

la plupart des systèmes de BGA sur la vente au détail sur le marché pour moins de £ 399 ont larges tolérances à savoir l'indicateur peut dire 200deg mais la tolérance pourrait être> <10% donc la chaleur produite peut effectivement être quelque chose de 180deg à 220deg .Dans ce cas, il est essentiel pour calibrer votre appareil en premier.

La température ambiante est également d'une importance vitale assurez-vous que la température ambiante de la pièce que vous utilisez est dans la gamme de 19deg à 21deg

Les instructions ci-dessus sont à titre indicatif seulement et computabench accepte aucune responsabilité pour panne ou des dommages aux composants causées par du personnel non qualifié  **https://www.youtube.com/watch?v=B7zN2S-23bA**